



東6ホール  
小間番号:6G-42

# JPCA Show 2024

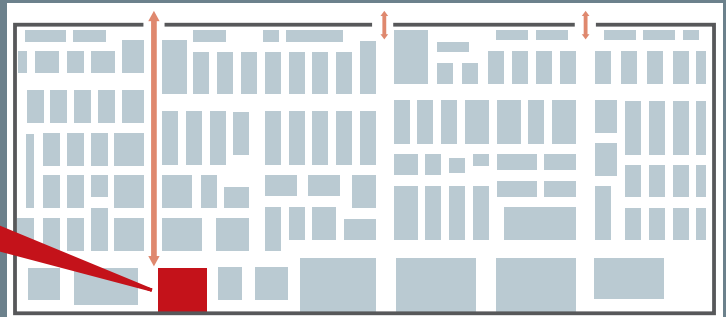
## 電子機器トータルソリューション展

開催日時 2024/6/12(水)~14(金) 10:00~17:00

場所 東京ビッグサイト  
東6ホール



小間番号  
6G-42



[ お問い合わせ先 ] 三菱電機株式会社 産業メカトロニクス事業部 TEL.03-3218-6555 [三菱電機FAサイト www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

### 会場のご案内



- **りんかい線**
    - 新木場駅 約5分
    - 大崎駅 約14分
  - **ゆりかもめ**
    - 新橋駅 約22分
    - 豊洲駅 約8分
  - **バス**
    - 【都営バス】
    - 東京駅八重洲口 約40分
    - 東京駅丸の内南口 約40分
    - 門前仲町 約35分
  - **空港バス (リムジンバス)**
    - 羽田空港 約25分
- 国際展示場駅(下車徒歩約7分)  
東京ビッグサイト駅(下車徒歩約3分)  
東京ビッグサイト  
東京ビッグサイト  
東京ビッグサイト  
各交通機関をご利用の際は、最新の運行状況をご確認ください。

東京ビッグサイト 〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1  
TEL:03(5530)1111(代表)

## ごあいさつ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は当社製品にひとかたならぬお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、来る6月12日(水)より6月14日(金)まで東京ビッグサイトにて「JPCA Show 2024」が開催されます。

弊社は、「最先端のプリント基板製造に提供する新たなソリューション」をテーマに、微小径穴加工を高速高精度かつ安定的に実現する新型基板穴あけ用UVレーザー加工機『GTF5-UVPシリーズ』の実機を出展するとともに、発売開始以来、多くのお客様にご好評を頂いております基板穴あけ用CO<sub>2</sub>レーザー加工機『GTW6シリーズ』、『GTF5シリーズ』をサイネージにて紹介いたします。また、プリント基板のトレーサビリティに必要な二次元コードや文字の高速微細印字を可能とした新型基板マーキング装置(※)、実装済み基板を個片に分割する基板分割機(※)を実機展示いたします。

つきましては、ご多忙中とは存じますが、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具

令和6年4月吉日

三菱電機株式会社 産業メカトロニクス事業部長 田代 勝

※名菱テクニカ株式会社製

## 最先端のプリント基板製造に提供する新たなソリューション

超高精度・微細加工

マザーボード・  
パッケージ基板の  
ビア加工

基板穴あけ用レーザー加工機

トレーサビリティ向上

基板への  
ダイレクトマーキング

基板マーキング装置

実装基板の高品質加工

低ストレス  
基板切断加工

基板分割機

新製品

パッケージ基板穴あけ用 レーザ加工機

ML605GTF5-UVP【実機展示】

パッケージ基板穴あけ用 レーザ加工機

ML605GTF5-5500UM【サイネージ展示】

HDI・パッケージ基板穴あけ用レーザー加工機

ML605GTW6-5500U【サイネージ展示】



基板分割機

MR2535H2T

【実機展示】〈名菱テクニカ製〉



新製品

表裏反転レーザー式  
基板マーキング装置

ML-PM20F3

【実機展示】〈名菱テクニカ製〉

展示会来場  
事前登録

<https://www.jpca-show.com/show2024/index.html>

※公式サイトよりe招待券(無料)をお申込みください。



JPCA Show 2024